



## Tagesordnung

Thema: 65. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **13. Februar 2019, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Surface Insulation Resistance (SIR) Test und Adaption an die Leistungselektronik  
*Herr Knofe, Siemens, Berlin*
- 3 10:50 Uhr  
Feuchte und Temperaturlast in optoelektronischen Sensorpackages –  
Materialcharakterisierung und FE Analyse mechanischer Spannungen  
*Herr Huber, ams AG, Premstaetten (AT)*
- 4 11:30 Uhr  
Einfluss des thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf die  
Temperaturwechselfestigkeit von Transformatoren und Elektronik-Modulen  
*Herr Bürger, ELANTAS Europe GmbH, Hamburg*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagessen
- 6 13:10 Uhr  
Nanoporöse Goldschichten - Ein alternatives Verbindungsmaterial in der  
Aufbau- und Verbindungstechnik  
*Frau Fröhlich, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Workshop** „Schneller und günstiger qualifizieren“

- 7                    13:50 Uhr  
Anforderungsprofile für den zuverlässigen Entwurf  
*Herr Straube, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 8                    14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9                    15:00 Uhr  
Workshop  
*Herr Straube und Herr Marwede, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 10                   16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**